

IPC-L0対応鉛フリーソルダペースト SL100



SL100はIPC-L0基準を満足する高信頼性鉛フリーソルダペーストです。保管や使用における粘度安定性に優れており、SMT工程における不良低減と作業性アップに貢献致します。

■ ソルダペースト分類

はんだ組成	SnPb	SAC305	高耐久	低融点
はんだ粒径	Type4 (20-38 μ m)	Type5 (15-25 μ m)	Type6 (5-15 μ m)	Type7 (2-11 μ m)
IPC-Flux type	L0	L1	M0	M1
対応リフロー条件	大気	窒素		

■ 特徴

- ・ IPC-L0基準を満足するSAC305鉛フリーソルダペーストです。
- ・ 連続使用における粘度安定性に優れており、一定の条件で長時間の生産が可能です。
- ・ Type4、Type5の2商品があり、汎用部品から微小部品まで幅広い電子部品接合に対応可能です。
- ・ 大気リフロー、窒素リフローの両条件に対応しています。

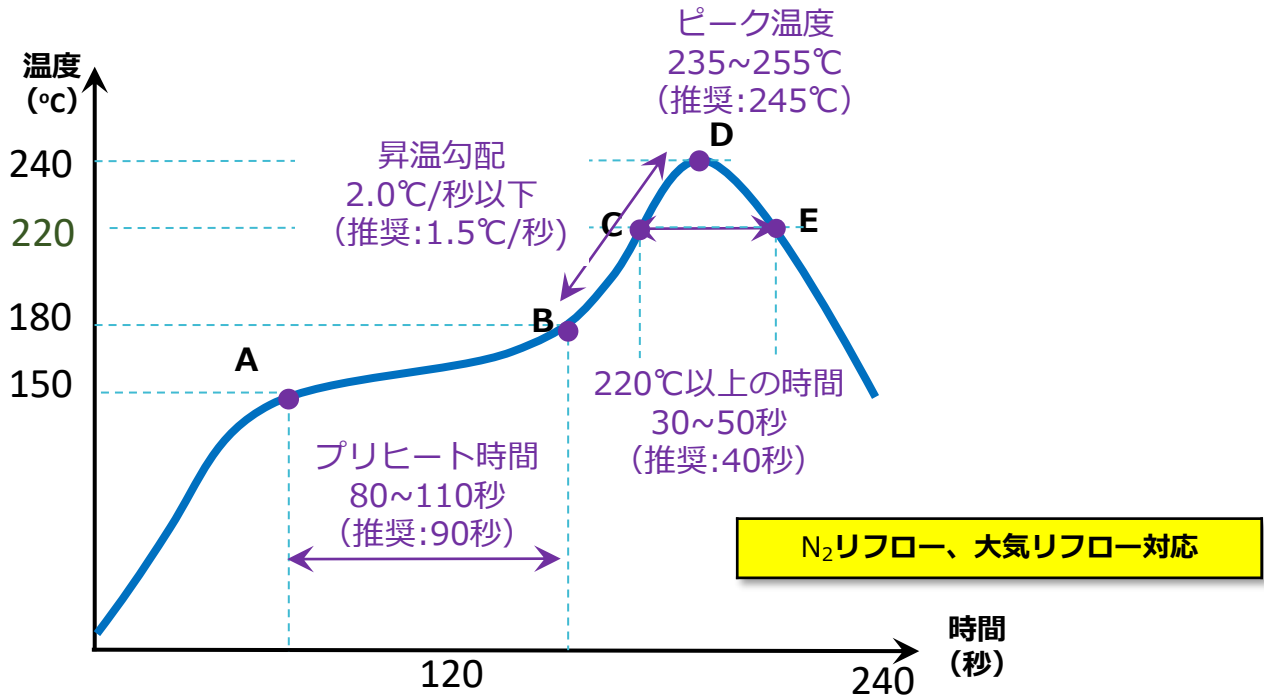
■ 性能一覧（代表値）

		性能（代表値）		備考
商品名		PS31BR-600-SL100	PS31BR-700-SL100	-
合金組成		Sn-3.0Ag-0.5Cu		-
はんだ粉末のサイズ分類		20-38 μ m(Type4)	15-25 μ m(Type5)	IPC J-STD-005A
フラックス分類		ROLO		IPC J-STD-004B
固相線温度		217 $^{\circ}$ C		JIS Z 3198-1
液相線温度		219 $^{\circ}$ C		
ハライド含有量		0.0%		IPC-TM-650
フラックス含有量		11.5%		-
銅板腐食		腐食なし		JIS Z 3197
絶縁抵抗		1 \times 10 ⁹ Ω 以上		
マイグレーション		発生なし		
乾燥度		フラックス残渣の粘着性なし		-
粘度特性	粘度	200Pa \cdot s	210Pa \cdot s	JIS Z 3284-3
	チクソトロピー指数	0.50	0.50	
印刷時のだれ		0.2mm間隔ブリッジなし		
加熱時のだれ		0.2mm間隔ブリッジなし		
粘着性		1.0N以上(初期~24時間後)		
ぬれ抗力/ディウェッティング		区分2/ディウェッティングなし		JIS Z 3284-4
ソルダボール		区分2(初期、24時間後)		
品質保証期間		製造後6ヶ月		冷蔵保管(0~10 $^{\circ}$ C)

IPC-L0対応鉛フリーソルダペースト SL100



■ 推奨温度プロファイル



■ 取り扱い注意事項

(1) 保管条件

- 1) 0~10℃ (冷蔵庫) で保管して下さい。
- 2) 直射日光をあてないで下さい。
- 3) 保管前に蓋がしっかりと閉まっていることを確認して下さい。

(2) 取り扱いの注意点

- 1) オペレーター以外の取扱いは避けて下さい。
- 2) 使用の際は、保護手袋と保護めがねを着用して下さい。
- 3) 皮膚にソルダペーストが付着した時は、エタノール等で速やかにふき取って下さい。
- 4) ソルダペーストを使用した後は、手をよく洗って下さい。
- 5) 作業場の換気には注意して下さい。

(3) 使用方法

- 1) ソルダペーストの温度が室温と同じになるまで、容器の蓋を開けないで下さい。
・ソルダペーストの温度が冷えた状態で蓋を開けますと、結露によりソルダペースト品質が悪化します。
*ヒーター等による急な加熱は避けて下さい。
- 2) 印刷する前に、ソルダペーストをよく攪拌してからご使用下さい。
自公転式ミキサー等を使用される際には、お客様ご使用の機器において条件出しをお願い致します。
- 3) 本ソルダペーストと他のソルダペースト、溶剤を同時に使用することは避けて下さい。
- 4) 推奨使用環境は、温度22~28℃、湿度50%RHです。